

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-025

芯联集成电路制造股份有限公司 关于拟对外出售资产及技术授权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”、“芯联集成”）及其子公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司、芯联先锋集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联集成及其子公司”），拟向芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司（以下简称“芯联先进”）转让并同步授权实施与之配套的专利及非专利型专有技术，转让及授权对价预计为 12.11 亿元。

- 本次交易不构成关联交易
- 本次交易不构成重大资产重组
- 本次交易事项已经第二届董事会第十六次会议审议通过。本次交易已达到股东会审议标准，尚须获得股东会的批准。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

1、本次交易概况

芯联先进作为“芯联 12 英寸车规级数模混合芯片制造项目”（以下简称“四期项目”）的实施主体，拟建设一条 5 万片/月的 12 英寸集成电路车规级数模混合芯片生产线。芯联集成在四期项目正式启动前，先行投入了研发资源并形成了相应的研发成果，以加快关键技术验证与客户产品导入进程，为芯联先进独立运

二、交易对方情况介绍

(一) 交易买方简要情况

序号	交易买方名称	交易标的	对应交易金额(亿元)
1	芯联先进	公司及其下属子公司持有的部分无形资产及开发支出	预计为 12.11 亿元

(二) 交易对方的基本情况

1、交易对方

法人/组织名称	芯联先进集成电路制造(绍兴)有限公司
统一社会信用代码	<input checked="" type="checkbox"/> 91330602MACW2ALW1Y <input type="checkbox"/> 不适用
成立日期	2023/09/14
注册地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联兴村 3 幢 108 室
主要办公地址	浙江省绍兴市柯桥区钱清街道联兴村 3 幢 108 室
法定代表人	陈志刚
注册资本	壹仟万元整
主营业务	一般项目：集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东/实际控制人	浙江绍兴杭绍临空示范区产业发展集团有限公司

交易对方或相关主体的主要财务数据如下：

单位：万元

披露主要财务数据的主体名称	芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司	
相关主体与交易对方的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 交易对方自身 <input type="checkbox"/> 控股股东/间接控股股东/实际控制人 <input type="checkbox"/> 其他，具体为_____	
项目	2025 年度/ 2025 年 12 月 31 日	2024 年度/ 2024 年 12 月 31 日
资产总额	28.77	不适用
负债总额	28.49	不适用
归属于母公司所有者权益	0.28	不适用
营业收入	28.77	不适用
营业利润	6.28	不适用
净利润	0.28	不适用

经查询，芯联先进资信良好，未被列为失信被执行人。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的基本情况

交易标的名称：公司及其下属子公司持有的无形资产及开发支出。

交易类别：出售资产及技术授权

2、交易标的的权属情况

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及妨碍权属转移的诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在其他妨碍权属转移的情况。

3、相关资产的运营情况

公司及其下属子公司持有的部分无形资产及开发支出均合法有效，能够满足生产经营需要。

(二) 交易标的主要财务信息

标的资产最近财务报表的账面价值情况如下：

单位：万元

标的资产名称	公司及其下属子公司持有的部分无形资产及开发支出	
标的资产类型	非股权资产	
标的资产具体类型	<input type="checkbox"/> 房产及土地 <input type="checkbox"/> 机器设备 <input type="checkbox"/> 债权 <input type="checkbox"/> 资产组 <input checked="" type="checkbox"/> 其他，具体为：无形资产及开发支出	
项目	2025年12月31日	2024年12月31日
账面原值	10,344.15	不适用
已计提的折旧、摊销	0.00	不适用
减值准备	0.00	不适用
账面净值	0.00	不适用
以上数据是否经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

四、交易标的评估、定价情况

(一) 定价情况及依据

1、本次交易的定价方法和结果。

为进行本次交易，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的金证（上海）资产评估有限公司以2026年4月30日为评估基准日，采用收益法，按照必要的评估程序，对芯联集成及其子公司拟出售的部分无形资产及开发支出进行评估，并出具了金证评报字【2026】A0533号资产评估报告、金证评报字【2026】A0536号资产评估报告，资产评估价值合计为12.11亿元，增值额为11.07亿元。

2、标的资产的具体评估、定价情况

标的资产名称	公司及其下属子公司持有的部分无形资产及开发支出
定价方法	<input type="checkbox"/> 协商定价 <input checked="" type="checkbox"/> 以评估或估值结果为依据定价 <input type="checkbox"/> 公开挂牌方式确定 <input type="checkbox"/> 其他：_____
交易价格	<input type="checkbox"/> 已确定，具体金额（万元）：_____ <input checked="" type="checkbox"/> 尚未确定
评估/估值基准日	2026/04/30
采用评估/估值结果 (单选)	<input type="checkbox"/> 资产基础法 <input checked="" type="checkbox"/> 收益法 <input type="checkbox"/> 市场法 <input type="checkbox"/> 其他，具体为：
最终评估/估值结论	评估/估值价值： <u>12.11</u> （亿元） 评估/估值增值率： <u>不适用</u>
评估/估值机构名称	金证（上海）资产评估有限公司

交易的评估定价情况

（一） 评估对象

本资产评估报告评估对象为芯联集成及其下属子公司持有的部分无形资产及开发支出。

（二） 评估范围

评估范围为经济行为之目的所涉及的芯联集成及其下属子公司于评估基准日申报的部分无形资产及开发支出。

截至评估基准日 2026 年 4 月 30 日，芯联集成及其下属子公司纳入评估范围的部分无形资产及开发支出的账面价值合计为 1.03 亿元。

（三） 评估方法的选择

本次采用收益法（收入分成法）评估，在预测未来与技术相关的营业收入基

基础上，采用收入分成率估算技术类无形资产及开发支出对销售收入的贡献额，并采用适当的折现率折为现值，以此确定技术类无形资产及开发支出的评估值。

（四）评估结论

采用收益法评估，纳入本次评估范围的无形资产及开发支出的账面价值合计为 1.03 亿元，评估价值合计为 12.11 亿元，增值额合计为 11.07 亿元。

本次出售资产的交易价格按照评估报告所确定评估值为基础，经交易双方友好协商确定，资产定价公平、合理，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、出售资产相关协议的主要内容及履约安排

1. 合同主体：

甲方：芯联集成电路制造股份有限公司及其子公司

乙方：芯联先进集成电路制造（绍兴）有限公司

2. 交易价格：基于评估报告以协商一致并经相关程序审核批准后为准，原则上不低于评估值。

3. 支付方式：分期现金支付

4. 交付或过户时间安排：所有标的资产均依照交割日按原样交付。

5. 合同生效条件及时间：甲乙双方经相关程序审核批准后自签署日开始生效。

6. 违约责任：在一方不履行或违反本协议任一条款的情形下，非违约方应书面通知另一方在合理期限内对违约进行补救。若违约方在前述期限内未能完成补救，非违约方可以书面通知另一方立即终止本协议，并要求赔偿由于违约方的违约行为给其带来的损害。就本协议下乙方付款义务的迟延履行，在不影响甲方根据适用法律或本协议享有的其他权利和救济的前提下，乙方应当向甲方支付迟

延违约金。

双方同意并确认，本协议生效后，转让方可以继续合法使用转让的标的资产，也即转让方可以以普通许可方式继续免费使用转让的专利。同时在双方约定的前提下，双方在知识产权上的改进、发展或修改，创造衍生知识产权，均同意与对方共有衍生知识产权。

上述合同暂未签订，具体内容以各方签署的最终协议约定为准。

六、出售资产对上市公司的影响

本次转让及授权所涉专利不会对芯联集成及其子公司的核心专利资产产生重大不利影响。本次交易价格公允合理，不存在损害公司和股东权益的情形。

本次交易预计将对公司 2026 年净利润产生积极影响，对公司本年度净利润的影响及具体会计处理以后续会计师事务所审计意见为准。

本次交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

七、风险提示

本次交易尚需满足股东会批准、交易双方正式签署协议等交割条件，具体完成情况存在不确定性。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年6月12日